



德國 Schlötter  
創立104年紀念

# Schlötter

Galvanotechnik

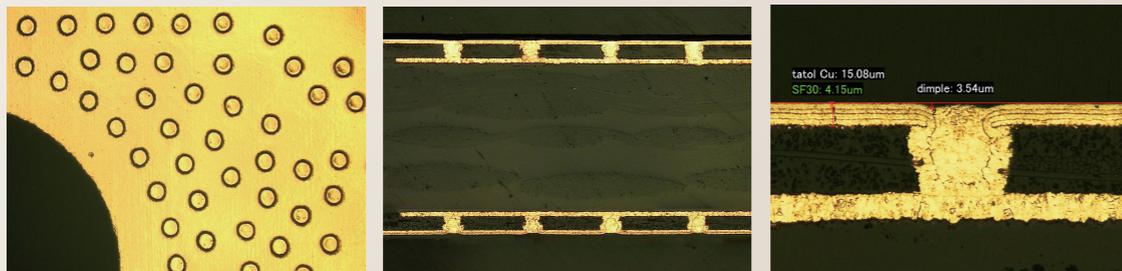
## SLOTOCOUP SF-30

滿足下一個世代微盲孔的挑戰!

全球最火紅的手機已開始進入下個年度的佈局設計，毫無疑問其盲孔尺寸及線路等級已朝IC規格靠近，即盲孔孔徑需縮至 70  $\mu\text{m}$ 以下，線路等級將達 30/35  $\mu\text{m}$ 。

在此一新的規範下，解決包孔及漏填已是極大的挑戰，況且在目前孔疏孔密差異極大的設計下，總銅厚仍需壓低至15  $\mu\text{m}$ 以內，更是艱鉅的難題。

如今對此一嚴峻之規範需求，SF-30 已完成測試及信賴性評估，無論是金屬化製程或一般打底填孔，即使面對縱橫比達到1.0之微盲孔，不但無盲孔漏填及包孔之現象發生，同時亦能維持面銅之超薄性，以及填孔之穩定度!



孔徑：60  $\mu\text{m}$ ，孔深：47  $\mu\text{m}$ ，鍍厚：4.15  $\mu\text{m}$ ，總銅厚：15.08  $\mu\text{m}$

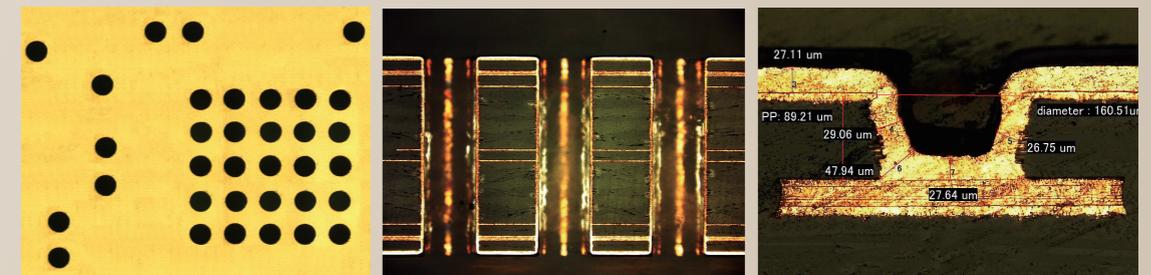
## SLOTOCOUP CU-1370

滿足汽車板五大需求之最佳鍍銅系統!

在汽車逐步電子化的需求下，汽車板的鍍銅要求日益嚴苛，以必須同時滿足五大需求為目前唯一的條件：

1. 通孔TP值 > 85 %
2. 盲孔不可折鍍
3. 孔口不可削肩
4. 孔疏孔密區之 R 值需最小
5. 符合信賴性TC-7最高安全係數規範。

CU-1370 為最新開發之鍍銅系統，不僅可一次完全滿足上述五大需求，同時在產線上之電流密度更可高達35 ASF以上，對產能之貢獻無與倫比!



Current density : 37 ASF ◦ A / R : 4~6 ◦ TP : > 90% ◦ no shoulder effect